附件5-1

一、享受《若干政策》第（一）条以及《公告》相关政策的集成电路生产企业或项目申报材料目录及模板

享受《若干政策》第（一）条以及《公告》

相关政策的集成电路生产企业或项目申报材料目录

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **材料** |
| 1 | 系统生成纸质文件 |
| 2 | 企业情况说明（参考模板1） |
| 3 | 企业法人营业执照副本 |
| 4 | 企业取得的其他相关资质证书（可提供相应查询网址） |
| 5 | 项目备案文件（备案表）（可提供相应查询网址） |
| 6 | 企业承诺书（系统下载） |
| 7 | 企业职工人数、学历结构、研发人员情况及其占职工总数的比例说明（参考模板2） |
| 8 | 研发人员名单（参考模板3，电子版需为EXCEL格式） |
| 9 | 汇算清缴年度最后一个月企业职工社保证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证） |
| 10 | 企业主要工艺、产品列表（名称/规格）（参考模板4） |
| 11 | 企业拥有与主营产品相关的专利列表（参考模板5）及对应证书 |
| 12 | 2023年度会计审计报告 |
| 13 | 2023年度专项审计报告（如审核指标已体现在企业会计审计报告中，可无需另外提供） |
| 14 | 与主要客户签订的两份代表性销售合同及发票等销售凭证复印件 |
| 15 | 企业具有保证产品生产的手段和能力的证明材料（包括采购设备清单等）（参考模板6） |
| 16 | 市发改委（市工信局）要求出具的其他材料 |

**纸质材料装订建议：**

1. 按照材料目录顺序胶装，并用彩页隔开各项内容；

2. 如有特殊情况，请附上加盖公章的情况说明；

3. 封面及书脊注明“申报年度+类别+公司名称”（如:2023年度享受《若干政策》第（一）条的集成电路线宽小于28 纳米（含）的集成电路生产企业：XX公司）；

4．封面上留下联系人及联系电话；

5. 如分册装订，请注明“共XX册，第XX册”；

电子光盘按材料类别建立文件夹，以材料名称命名文件名（如一、系统生成的纸质文件），审计报告及专项审计报告、测试报告、合同等涉及多页的文档按份扫描成PDF格式（不要一张一个图片或者文件）。

**参考模板1**

**XXX公司情况说明**

提纲（包括但不限于）：

一、企业业务简介

从公司成立背景、核心技术、主要产品、业务特点、主要客户或服务对象、商业模式等方向进行简要描述。

二、其他需要说明的事项

联系人/职务/手机：

公司名称（盖章）：

年 月 日

**参考模板2**

**XXX公司人员构成情况说明**

企业从事8英寸及以下集成电路生产（**注意：如果未从事8英寸及以下生产，删掉此句即可**）。

2023年，具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系，企业月平均职工总人数为 人，其中具有本科及以上学历的月平均职工人数为 人，占当年月平均职工总人数的比例为 %。

2023年，具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系，企业研究开发人员月平均数为 人，占当年月平均职工总人数的比例为 %。

2023年12月企业缴纳社会保险人员（包括劳务派遣人员代缴社保） 人，其中劳务派遣人员代缴社保人数为 人。

说明：

1、月平均人数计算：月平均数=（月初数+月末数）÷2；

2、年度月平均数=全年各月平均数之和÷12

公司名称（盖章）：

年 月 日

**参考模板3**

**研发人员名单**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **岗位** | **学历** | **毕业院校** | **专业** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：①表格内仅填写汇算清缴年度最后一个月的人员情况；②研发人员主要包括研究人员、技术人员和辅助人员（技工）。**

**参考模板4**

**企业主要工艺、产品列表**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工艺、产品名称** | **工艺、产品规格** | **备注** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：工艺部分填写时需要体现具体线宽，例如：28nm FinFET工艺**

**参考模板5**

**企业拥有与主营产品相关的专利列表**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利类型** | **专利名称** | **专利号** | **专利申请时间** | **专利授权时间** | **专利有效期** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：①表格内填写的专利，应为企业以此为基础开展经营活动；②专利列表中必须包含企业拥有的与主营产品相关的发明专利等；③企业提供的专利证明材料，应与表格保持一致。**

**参考模板6**

**企业具有保证产品生产的手段和能力证明材料**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **提供商/国别** | **设备型号** | **数量（台/套）** | **自购/租用** |
| **一、硬件设备** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、软件设备** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **三、场地** | | | | | |
| **位置** |  | | **面积** |  | |

**注：除上表外，还需提供具有保证产品生产手段和能力的文字简述（包括但不限于研发及生产水平，具有保证相关工艺线宽产品生产的手段和能力，结合软硬件设备对产品研发生产手段和能力介绍）、软硬件设备及研发生产场地照片、采购合同等证明材料。**

二、享受《若干政策》第（三）（七）条以及《公告》相关政策的重点集成电路设计企业申报材料目录及模板

享受《若干政策》第（三）（七）条以及《公告》

相关政策的重点集成电路设计企业申报材料目录

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **材料** |
| 1 | 系统生成纸质文件 |
| 2 | 企业情况说明（参考模板1） |
| 3 | 企业法人营业执照副本 |
| 4 | 企业取得的其他相关资质证书（可提供相应查询网址） |
| 5 | 企业承诺书（系统下载） |
| 6 | 企业职工人数、学历结构、研发人员情况及其占职工总数的比例说明（参考模板2） |
| 7 | 研发人员名单（参考模板3，电子版需为EXCEL格式） |
| 8 | 汇算清缴年度最后一个月企业职工社保证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证） |
| 9 | 企业开发销售的主要产品和服务列表（参考模板4） |
| 10 | 企业拥有与主营产品相关的知识产权列表（参考模板5）及对应证书 |
| 11 | 2023年度会计审计报告 |
| 12 | 2023年度专项审计报告（如审核指标已体现在企业会计审计报告中，可无需另外提供） |
| 13 | 第三方检测机构提供的集成电路产品测试报告或用户报告 |
| 14 | 与主要客户签订的两份代表性销售合同及发票等销售凭证复印件 |
| 15 | 税务鉴证报告等可说明企业符合应纳税所得额条件的证明材料 |
| 16 | 企业具有与集成电路设计相适应的软硬件设施等开发环境的证明材料（包括采购设备清单等）（参考模板6） |
| 17 | 市发改委（市工信局）要求出具的其他材料 |

**纸质材料装订建议：**

1. 按照材料目录顺序胶装，并用彩页隔开各项内容；

2. 如有特殊情况，请附上加盖公章的情况说明；

3. 封面及书脊注明“申报年度+类别+公司名称”（如:2023年度享受《若干政策》第（三）（七）条的重点集成电路设计企业：XX公司）；

4．封面上留下联系人及联系电话；

5. 如分册装订，请注明“共XX册，第XX册”；

电子光盘按材料类别建立文件夹，以材料名称命名文件名（如一、系统生成的纸质文件），审计报告及专项审计报告、测试报告、合同等涉及多页的文档按份扫描成PDF格式（不要一张一个图片或者文件）。

**参考模板1**

**XXX公司情况说明**

提纲（包括但不限于）：

一、企业业务简介

从公司成立背景、核心技术、主要产品、业务特点、主要客户或服务对象、商业模式等方向进行简要描述。

二、所申报重点领域说明（包括但不限于知识产权匹配度、重点领域销售收入占比等）

三、其他需要说明的事项

联系人/职务/手机：

公司名称（盖章）：

年 月 日

**参考模板2**

**XXX公司人员构成情况说明**

2023年，具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系，企业月平均职工总人数为 人，其中具有本科及以上学历的月平均职工人数为 人，占当年月平均职工总人数的比例为 %。

2023年，具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系，企业研究开发人员月平均数为 人，占当年月平均职工总人数的比例为 %。

2023年12月企业缴纳社会保险人员（包括劳务派遣人员代缴社保） 人，其中劳务派遣人员代缴社保人数为 人。

说明：

1、月平均人数计算：月平均数=（月初数+月末数）÷2；

2、年度月平均数=全年各月平均数之和÷12

公司名称（盖章）：

年 月 日

**参考模板3**

**研发人员名单**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **岗位** | **学历** | **毕业院校** | **专业** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：①表格内仅填写汇算清缴年度最后一个月的人员情况；②研发人员主要包括研究人员、技术人员和辅助人员（技工）。**

**参考模板4**

**企业开发销售的主要产品和服务列表**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品和服务名称** | **重点领域** | **对应销售（营业）收入规模（万元）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：重点领域指国家鼓励的重点集成电路设计领域。**

**参考模板5**

**企业拥有与主营产品相关的知识产权列表**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **知识产权类型** | **名称** | **专利号/登记号** | **申请时间** | **授权时间** | **有效期** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：①知识产权包括：已授权发明专利（企业为第一权利人）、布图设计、计算机软件著作权；②表格内填写的知识产权，应为企业以此为基础开展经营活动；③列表中必须包含企业拥有的与主营产品相关的不少于8项的已授权发明专利（企业为第一权利人）、布图设计、计算机软件著作权；④企业提供的知识产权证明材料，应与表格保持一致。**

**参考模板6**

**企业具有与集成电路设计相适应的软硬件设施等开发环境**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **提供商/国别** | **设备型号** | **数量（台/套）** | **自购/租用** |
| **一、硬件设备** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、软件设备** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **三、场地** | | | | | |
| **位置** |  | | **面积** |  | |

**注：除上表外，还需提供开发环境文字简述（包括研发及生产水平、结合软硬件设施对研发手段和能力介绍）、软硬件设施及研发场地照片、采购合同、正版的EDA软硬件工具等证明材料。**

三、享受《若干政策》第（六）条相关政策的集成电路生产企业和财关税〔2021〕4号文提及的关键原材料、零配件生产企业申报材料目录及模板

享受《若干政策》第（六）条相关政策的集成电路

生产企业和财关税〔2021〕4号文提及的关键

原材料、零配件生产企业申报材料目录

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **材料** |
| 1 | 系统生成纸质文件 |
| 2 | 企业情况说明（参考模板1） |
| 3 | 企业法人营业执照副本 |
| 4 | 企业取得的其他相关资质证书（可提供相应查询网址） |
| 5 | 项目备案文件（备案表）（可提供相应查询网址） |
| 6 | 企业承诺书（系统下载） |
| 7 | 企业具有保证产品生产的手段和能力的证明材料（包括采购设备清单等）（参考模板2） |
| 8 | 先进封装、测试企业提供按封装产品颗粒数或晶圆数（折合8 英寸）计算，先进封装测试（晶圆级封装、系统级封装、2.5 维和3 维封装）规划产能占总规划产能比例不低于40%的证明材料 |
| 9 | 市发改委（市工信局）要求出具的其他材料 |

**纸质材料装订建议：**

1. 按照材料目录顺序胶装，并用彩页隔开各项内容；

2. 如有特殊情况，请附上加盖公章的情况说明；

3. 封面及书脊注明“申报年度+类别+公司名称”（如:2023年度享受《若干政策》第（六）条的集成电路线宽小于65纳米（含）的逻辑电路生产企业：XX公司）；

4．封面上留下联系人及联系电话；

5. 如分册装订，请注明“共XX册，第XX册”；

电子光盘按材料类别建立文件夹，以材料名称命名文件名（如一、系统生成的纸质文件），审计报告及专项审计报告、测试报告、合同等涉及多页的文档按份扫描成PDF格式（不要一张一个图片或者文件）。

**参考模板1**

**XXX公司情况说明**

提纲（包括但不限于）：

一、企业业务简介

从公司成立背景、核心技术、主要产品、业务特点、主要客户或服务对象、商业模式等方向进行简要描述。

二、其他需要说明的事项

联系人/职务/手机：

公司名称（盖章）：

年 月 日

**参考模板2**

**企业具有保证产品生产的手段和能力证明材料**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **提供商/国别** | **设备型号** | **数量（台/套）** | **自购/租用** |
| **一、硬件设备** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、软件设备** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **三、场地** | | | | | |
| **位置** |  | | **面积** |  | |

**注：除上表外，还需提供具有保证产品生产手段和能力的文字简述（包括但不限于研发及生产水平，集成电路生产企业具有保证相关工艺线宽产品生产的手段和能力，先进封装测试企业具有先进封装测试产品生产的手段和能力，结合软硬件设备对产品研发生产手段和能力介绍）、软硬件设备及研发生产场地照片、采购合同等证明材料。**

四、享受《若干政策》第（八）条相关政策的集成电路重大项目申报材料目录及模板

享受《若干政策》第（八）条相关政策的

集成电路重大项目申报材料目录

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **材料** |
| 1 | 系统生成纸质文件 |
| 2 | 项目情况说明（参考模板1） |
| 3 | 企业法人营业执照副本 |
| 4 | 企业取得的其他相关资质证书（可提供相应查询网址） |
| 5 | 项目备案文件（备案表）（可提供相应查询网址） |
| 6 | 企业承诺书（系统下载） |
| 7 | 企业具有保证产品生产的手段和能力的证明材料（包括采购设备清单等）（参考模板2） |
| 8 | 集成电路重大项目基本信息表及相关证明材料（参考模板3） |
| 9 | 市发改委（市工信局）要求出具的其他材料 |

**纸质材料装订建议：**

1. 按照材料目录顺序胶装，并用彩页隔开各项内容；

2. 如有特殊情况，请附上加盖公章的情况说明；

3. 封面及书脊注明“申报年度+类别+项目名称”（如:2023年度享受《若干政策》第（八）条的集成电路重大项目：XX项目）；

4．封面上留下联系人及联系电话；

5. 如分册装订，请注明“共XX册，第XX册”；

电子光盘按材料类别建立文件夹，以材料名称命名文件名（如一、系统生成的纸质文件），审计报告及专项审计报告、测试报告、合同等涉及多页的文档按份扫描成PDF格式（不要一张一个图片或者文件）。

**参考模板1**

**XXX项目情况说明**

提纲（包括但不限于）：

一、项目简介

从项目设立背景、项目公司介绍、核心技术、主要产品、业务特点、主要客户或服务对象、商业模式等方向进行简要描述。

二、其他需要说明的事项

联系人/职务/手机：

公司名称（盖章）：

年 月 日

**参考模板2**

**企业具有保证产品生产的手段和能力证明材料**

公司名称（盖章）： 填写日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **提供商/国别** | **设备型号** | **数量（台/套）** | **自购/租用** |
| **一、硬件设备** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、软件设备** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **三、场地** | | | | | |
| **位置** |  | | **面积** |  | |

**注：除上表外，还需提供具有保证产品生产手段和能力的文字简述（包括但不限于研发及生产水平，具有保证相关工艺线宽产品生产的手段和能力，结合软硬件设备对产品研发生产手段和能力介绍）、软硬件设备及研发生产场地照片、采购合同等证明材料。**

**参考模板3**

**集成电路重大项目基本信息表**

公司名称（公章）： 填写日期：XXXX年XX月XX日

**一、线宽小于65纳米（含）的逻辑电路、存储器项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **承建企业名称** | **所在地区** | **项目名称** | **项目开工时间** | **项目竣工时间** | **备案号** | **备案时间** | **固定资产总投资额** | **项目类型** | **产品类型** | **工艺线宽** | **规划月产能（折合12英寸）** | **其他要说明情况** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中项目基本情况需按照备案信息填写，并提交项目窗口指导批复、备案、正式版可行性研究报告

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年7月27日后至本项目竣工前本项目申请进口环节增值税分期纳税的进口新设备需求** | | | | | | |
| **首台新设备名称** | **首台新设备型号** | **首台新设备进口时间** | **单价（万元）** | **数量（台/套）** | **进口设备总金额（万元）** | **进口环节增值税额（万元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：2020年7月27日后至本项目竣工前申请进口环节增值税分期纳税的首台新设备基本信息证明材料包括：设备进口时海关出具的相关单据等

**二、线宽小于0.25微米（含）的特色工艺芯片制造项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **承建企业名称** | **所在地区** | **项目名称** | **项目开工时间** | **项目竣工时间** | **备案号** | **备案时间** | **固定资产总投资额** | **项目类型** | **产品类型** | **工艺线宽** | **规划月产能（折合8英寸）** | **其他要说明情况** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中项目基本情况需按照备案信息填写，并提交项目窗口指导批复、备案、正式版可行性研究报告

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年7月27日后至本项目竣工前本项目申请进口环节增值税分期纳税的进口新设备需求** | | | | | | |
| **首台新设备名称** | **首台新设备型号** | **首台新设备进口时间** | **单价（万元）** | **数量（台/套）** | **进口设备总金额（万元）** | **进口环节增值税额（万元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：2020年7月27日后至本项目竣工前申请进口环节增值税分期纳税的首台新设备基本信息证明材料包括：设备进口时海关出具的相关单据等

三**、线宽小于0.5微米（含）的基于化合物集成电路制造项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **承建企业名称** | **所在地区** | **项目名称** | **项目开工时间** | **项目竣工时间** | **备案号** | **备案时间** | **固定资产总投资额** | **项目类型** | **产品类型** | **工艺线宽** | **规划月产能（折合6英寸）** | **其他要说明情况** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中项目基本情况需按照备案信息填写，并提交项目窗口指导批复、备案、正式版可行性研究报告

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年7月27日后至本项目竣工前本项目申请进口环节增值税分期纳税的进口新设备需求** | | | | | | |
| **首台新设备名称** | **首台新设备型号** | **首台新设备进口时间** | **单价（万元）** | **数量（台/套）** | **进口设备总金额（万元）** | **进口环节增值税额（万元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：2020年7月27日后至本项目竣工前申请进口环节增值税分期纳税的首台新设备基本信息证明材料包括：设备进口时海关出具的相关单据等

**四、先进封装测试类重大项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **承建企业名称** | **所在地区** | **项目名称** | **项目开工时间** | **项目竣工时间** | **备案号** | **备案时间** | **固定资产总投资额** | **项目类型** | **产品类型** | **规划封装年产能** | **先进封装测试规划产能** | **其他要说明情况** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中项目基本情况需按照备案信息填写，并提交项目窗口指导批复、备案、正式版可行性研究报告

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年7月27日后至本项目竣工前本项目申请进口环节增值税分期纳税的进口新设备需求** | | | | | | |
| **首台新设备名称** | **首台新设备型号** | **首台新设备进口时间** | **单价（万元）** | **数量（台/套）** | **进口设备总金额（万元）** | **进口环节增值税额（万元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：2020年7月27日后至本项目竣工前申请进口环节增值税分期纳税的首台新设备基本信息证明材料包括：设备进口时海关出具的相关单据等